

Title (en)  
Microrelay with new construction

Title (de)  
Mikrorelais mit neuem Aufbau

Title (fr)  
Microrelais à nouvelle construction

Publication  
**EP 1246215 A1 20021002 (DE)**

Application  
**EP 01810322 A 20010329**

Priority  
EP 01810322 A 20010329

Abstract (en)  
A drive capacitor (4,5) drives a movable contact piece (MCP) (1) electrostatically and has two conductive surfaces set apart but parallel. One (4) of these surfaces is applied to one side of the MCP with a flexible suspension (2). Altering the charging status of the drive capacitor moves the MCP into and out of a structure on a mating contact piece (6,7) in order to open and close an electrical contact between the MCP and the mating contact piece.

Abstract (de)  
Die Erfindung bezieht sich auf ein Mikrorelais mit neuem mechanischem Aufbau, bei dem die Bewegungsrichtung eines bewegbaren Kontaktstücks (1) im wesentlichen senkrecht zu der elektrostatischen Antriebskraft eines Antriebskondensators (4, 5) liegt. Dadurch können mit kleinen Versorgungsspannungen relativ große Kontaktkräfte und hohe Spannungsfestigkeiten im geöffneten Zustand realisiert werden. <IMAGE>

IPC 1-7  
**H01H 59/00**

IPC 8 full level  
**H01H 59/00** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**H01H 59/0009** (2013.01); **H01H 2001/0078** (2013.01)

Citation (search report)  
• [X] EP 1020984 A2 20000719 - SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]  
• [A] WO 9303385 A1 19930218 - BOSCH GMBH ROBERT [DE]  
• [A] US 5375033 A 19941220 - MACDONALD NOEL C [US]

Cited by  
EP1463081A3; EP1463081A2; WO2005015595A1; WO2007059634A1

Designated contracting state (EPC)  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

DOCDB simple family (publication)  
**EP 1246215 A1 20021002; EP 1246215 B1 20091209**; AT E451712 T1 20091215; DE 50115251 D1 20100121

DOCDB simple family (application)  
**EP 01810322 A 20010329**; AT 01810322 T 20010329; DE 50115251 T 20010329